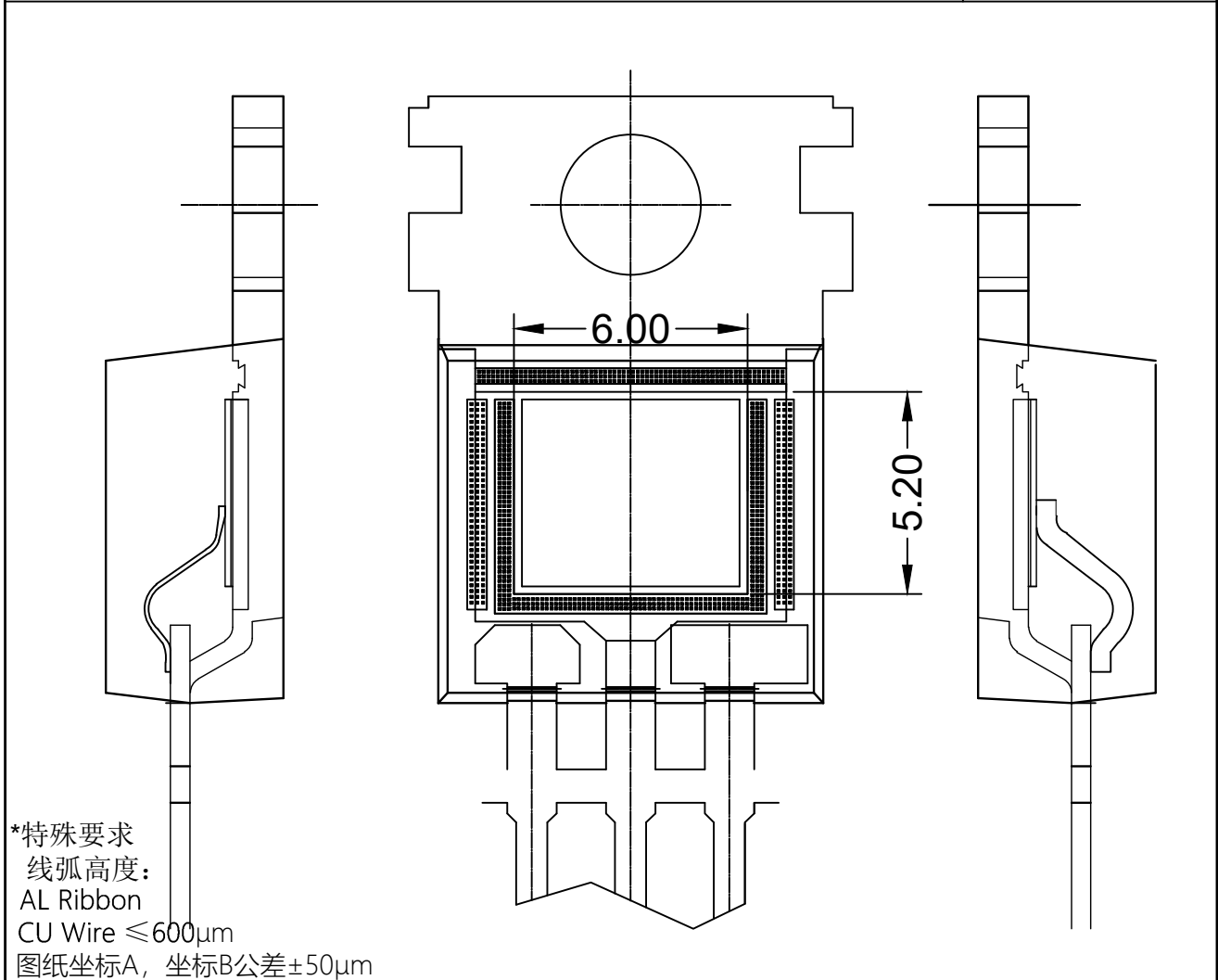




装片键合配线图

配线图号		版本号		封装外形	T0-220C-3L
装片方向	引线框传输方向				客户回签



*特殊要求
线弧高度:
AL Ribbon
CU Wire $\leq 600\mu\text{m}$
图纸坐标A, 坐标B公差 $\pm 50\mu\text{m}$

			封装信息			
			装片方式		焊线方式	
			框架型号		G极焊线	
	芯片厚度 (um)		框架镀层		S极焊线	
	晶圆正面金属		基岛尺寸 (mm)	6.00 * 5.20	总线数	
	晶圆背金		电镀方式	雾锡	制图日期	
			备注			
	审核		批准		文控发行章	